**优化中国科技制造业融资环境**

来源：中国电子报、电子信息产业网 作者：邱江勇

2025年全国两会召开之际，全国人大代表，TCL创始人、董事长李东生接受了《中国电子报》等媒体的专访。李东生表示，TCL一直坚持为未来投资，民营经济向好，整个经营大环境向好，大家对发展要充满信心。不久前，TCL正式成为奥林匹克全球合作伙伴，这让其全球化叙事又多了一个新注脚。

今年全国两会上，李东生再一次提及优化中国科技制造业融资环境。他对此解释道，与全球领先的科技企业相比，中国科技制造业还处于追赶超越阶段，特别是集成电路制造、半导体显示及新能源汽车等产业。在这个阶段，中国的集成电路、半导体显示没有足够融资支持的话，很难发展起来。

李东生以台积电、三星半导体举例，它们拥有的总资产、净资产远远超过竞争对手，每年产生的经营现金流、利润都非常大，不依靠对外融资就可以支撑自身的投资计划。而中国这些投资主体的发展还远没有到台积电、三星半导体的水平。

过去4年，TCL华星新增固定资产投资1080亿元，在半导体显示产业累计投资2700亿元。“科技制造业是整个中国制造业竞争力的基础，如果中国没有面板产业，就不可能有现在中国消费电子产业链在全球市场的地位。”李东生表示，这些产业投入资本金大、回收周期长，且需持续投资，亟需相应的权益性资本融资。

为此，李东生提出三点建议：一是对头部科技制造业提供资本市场的创新服务和支持；二是对头部科技制造业适度放宽股权融资限制；三是按照明确的法规审批项目，提高资本市场融资的可预期性。

“未来3-5年，融资对我们来讲还是发展的一个必要条件，这能建立和巩固中国企业、中国科技制造业在全球的领先地位。”李东生做了“大胆预测”，“5年后，TCL华星也好，京东方也好，我们不需要再依靠资本市场再融资来发展，我们自身的资金就足够来滚动了。”

李东生认为，中国科技制造业已具备性价比和质量的双重优势，之前在成本效率方面有优势，现在技术创新方面也快速赶上了，“DeepSeek就是我们在大数据、人工智能大模型方面跑出来的一个新技术”。据了解，TCL通过AI技术的多场景落地应用，2024年已创造经济效益超过5.4亿元。TCL已经把AI技术应用到生产制造供应链的智能化改造，并导入产品的设计研发。李东生强调，AI技术的真正价值在于应用。

“我们在制造方面的AI应用一直在进行，而且取得了比较好的效果。”李东生告诉记者，借助DeepSeek大模型技术，有可能把TCL的算力中心做得更大，更好地支撑企业的智能化发展。

李东生也指出，随着生成式人工智能技术的发展，深度伪造技术也快速发展。他建议从加快出台管理规章制度，明确惩罚制度、标识技术标准和发布管理、国际合作等方面，加强AI深度伪造欺诈管理。